

证券代码：300964

证券简称：本川智能

江苏本川智能电路科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投基金管理有限公司 天风证券股份有限公司（中小盘研究团队） 国元证券股份有限公司 杭州谭石资本 上海赋格投资管理有限公司 上海臻宜投资管理有限公司
时间	2026年5月28日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	1、董事长董晓俊先生； 2、财务负责人、董事会秘书董超先生； 3、研发总监张建波先生。
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况： 1、公司 CIPB 项目的技术原理、核心优势及应用场景是什么？市场前景如何？ 答：CIPB（芯片埋入功率板）是新一代电力电子技术，通过将结构件、元件与 PCB 重塑集成，实现芯片与基板的一体化封装，解决传统叠层架构体积大、散热差、寄生电感高等痛点。 (1) 核心技术优势 电气性能提升：相比传统模块，寄生电感降低 90%以上，开关损耗显著降低，电源转换效率大幅提升。

热管理与可靠性：通过背面直贴高导热层，结温降低 15-20 度，支持 200 度高温运行；功率循环次数超过 10 万次，是传统方案的 3-10 倍。

高集成度与小体积：省去独立驱动板和连接端子，面积缩小 30%-50%，功率密度提升 2-3 倍。

成本优势明显：通过简化结构和工艺，预计比传统方案降低成本 20%-30%。

（2）核心应用场景

AI 服务器电源：适配 450W-500W 超高功率挑战，效率提升 3%-5%，体积缩小 50%。

新能源汽车：助力逆变器实现 1200KW 高功率密度，体积缩小 1/4。

储能光伏：开关损耗降低 50%，整机效率提升 2%-4%，寿命提升 3 倍。

机器人：关节驱动体积缩小 60%-80%，响应速度提升 50% 以上。

（3）市场前景

预计到 2030 年，CIPB 对应下游市场规模广阔，其中服务器电源市场 90-250 亿元，新能源汽车 60-150 亿元，光伏逆变器 50-160 亿元，机器人模块 350-650 亿元。

2、公司当前核心业务板块及营收情况如何？

答：

（1）核心业务板块情况

通讯设备：公司紧跟 5G/6G 技术演进、光模块迭代和卫星通信产业化趋势，不断优化产品结构，保持行业竞争优势。

工业控制：公司聚焦工业自动化设备、工业机器人等应用场景，提供高精密、高抗干扰、长寿命的 PCB 产品，适配复杂工作环境，业务发展保持稳健增长，为公司经营发展提供了稳定的收入支撑。

汽车电子：已覆盖多家国内外主流整车厂与 Tier 1 供应商，与行业领军者建立长期稳定的合作关系，持续深化战略合作。正在与部分头部车企就 CIPB 产品开展样品验证，将进一步提升公司在高端市场的份额，实现更深层次的战略绑定。

新能源领域：公司重点研发生产大功率、高可靠性的 PCB 产品，精准聚焦储能和充电桩两大核心领域，打造差异化竞争优势，成功切入多家行业头部供应链体系。

AI 领域：公司 CIPB 产品已顺利完成对头部 AI 服务器电源客户的样品验证环节，目前已正式进入其供应链体系，并开始小批量生产，持续推动商业化。

机器人领域：切入新兴赛道，为商用清洁机器人等提供定制化 PCB 解决方案，可应用于底盘驱动、电源管理、中央控制、伺服模组等核心部件。

(2) 公司营收情况

2025 年营收同比增长 46.94%，归母净利润同比增长 33.74%；2026 年 Q1 营收同比增长 38.06%，综合毛利率约 19.26%，资产负债率较低，现金流良好。

3、公司在 AI 服务器领域具体做哪一部分？是否涉及服务器主板？

答：公司目前主要聚焦于 AI 服务器电源（一次电源）等细分市场，走差异化路线。

4、公司 CIPB 项目的商业化进展、量产准备及客户拓展情况如何？

答：公司正在进行对 CIPB 项目的厂房改造和定制化产线布局，目前已有 6 家客户完成多版打样，3 家客户进入小批量试产阶段。

项目目前处于小批量试产阶段，大规模放量预计在未来 1-2 年。公司已针对不同材料热膨胀系数差异导致的翘曲问题，完成 10 种以上材料验证，解决了高压绝缘、激光开槽、微孔填镀等

	<p>核心技术难题；同时与上游芯片厂商、模块厂深度合作，打通了从材料到成品的全链路供应能力，为后续规模化量产做好了准备。</p> <p>5、相比传统方案，公司 CIPB 技术产品会增加多少成本？</p> <p>答：目前样品阶段成本较高，但量产化后预计比模块厂方案低，且性价比（性能/可靠性）优于传统方案。</p> <p>6、公司 CIPB 后续工艺技术发展方向是什么？</p> <p>答：嵌入式集成是 PCB 行业主流发展趋势，公司已完成埋铜、埋阻工艺积累，稳步向埋芯方向升级，持续布局埋硅、埋电容等前沿嵌入式方案，持续夯实技术壁垒。</p> <p>7、请问公司现阶段经营现状、面临的经营挑战以及后续发展规划是怎样的？</p> <p>答：目前公司整体经营态势良好，现阶段我们持续优化客户与订单结构，着力提升整体毛利率与净利率。当前公司产能处于高位运行状态，目前已有扩产计划；叠加 CCL、电子布等原材料价格持续上涨，对此公司已提前进行原材料备货，保障生产稳定。公司正结合行业发展趋势，在技术积累与产品结构方面持续优化，逐步推动高附加值产品占比的合理提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 28 日